

证券代码：688328

证券简称：深科达

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	工银理财 南方基金 博时基金 中金公司 中国中信金融资产 建信基金 大成基金 诺安基金 太平资产 申万菱信 摩根士丹利基金 兴业证券投资部 国华兴益保险资管 敦和资产 华创证券 金鹰基金 恒生前海基金 仁桥资产 沅京资本 创金合信 信达澳亚 财通基金 东方基金 蜂巢基金 格林基金 汉和汉华资本 石锋资产 趣时资产 域秀资本 神农投资 望正资产 昆仑健康保险 上海证券 中融汇信期货 博普资产 珺容投资 鹤禧投资 珞珈方圆资产 禾升投资 玄卜投资 精砚私募 明亚基金 云溪基金 象上私募 恒邦兆丰私募 俊腾私募 海金投资 仙人掌资产
时间	2026 年 3 月 16 日
地点	线上会议
接待人员	董事会秘书：郑亦平
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司主要业务都有哪些？ 答：公司是一家专业的智能装备及核心部件制造厂商，拥有科学完整的研发、生产和销售运营体系，能够为客户提供相关自动化设备的整体解决方案。公司主要从事半导体类设备、平板显示模组类设备、以及智能装备关键零部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于半导体封

测、平板显示器件（显示模组、触控模组、指纹识别模组）的自动化组装和智能化检测，并向智能装备关键零部件等领域进行延伸。

## 2、公司目前半导体设备业务订单情况？

答：随着全球半导体设备行业景气度持续复苏，公司通过持续推进产品迭代升级，不断提升产品的综合竞争力。其中，转塔式测试分选机保持与国内外半导体封测厂商、IDM 企业的良好合作；平移式测试分选机上一年度市场开拓取得阶段性成果，获得下游客户高度认可，已实现批量订单落地。

## 3、公司 2025 年整体的经营情况？

答：根据公司 2026 年 2 月 28 日披露的业绩快报数据：2025 年公司实现营业收入 67,268.71 万元，与上年同期相比增长 32.14%；实现营业利润 4,037.90 万元，实现利润总额 3,939.94 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 2,502.01 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,223.50 万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。以上数据为公司财务初步核算结果，具体以经审计的 2025 年年报为准。

## 4、公司在存储设备市场布局情况？

答：AI 算力爆发带动存储需求持续增长，行业供需偏紧，存储产线扩产与自动化升级需求旺盛。公司依托精密贴合、半导体设备领域的技术积累，切入存储设备赛道。现阶段公司已与北美存储客户建立直接合作，为其提供存储 AOI 检测设备、高精度芯片贴合设备、磁头测试产线自动化设备等多款产品。虽然当前该业务在手订单占公司整体营收比例较小，但公司将持续把握行业发展机遇，稳步推进相关业务的拓展。

## 5、公司与北美存储客户的合作情况及需求来源？

答：公司自 2019 年起与该存储客户展开合作切入存储领域。近两年来，公司持续积极配合客户推进上述相关设备产品的研发及订单交付，现阶段公司是该客户对应业务的唯一合作供应商。

客户对相关存储设备需求主要来源于其布局 HAMR 技术（热辅助磁记录技术），旨在突破传统硬盘密度瓶颈，进一步提高硬盘容量，进而实现

	<p>产品性能的显著优化。</p> <p>6、公司近期是否有资本运作计划，如实施新的股权激励计划？</p> <p>答：公司目前暂无相关资本运作计划，短期内亦无新的股权激励计划及再融资安排。公司已于 2026 年 3 月 6 日披露公告，综合考虑股权激励费用大幅增加等多重因素的影响，决定终止前次股权激励计划；未来公司将结合经营发展状况，择机推进适配的股权激励方案。</p> <p>7、公司 3 月 16 日股价下跌是否因公司经营情况发生变化？</p> <p>答：公司目前生产经营活动一切正常，经营情况良好，主营业务及内外部经营环境未发生重大变化。二级市场股价波动受宏观环境、行业政策、市场情绪等多重因素综合影响。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>